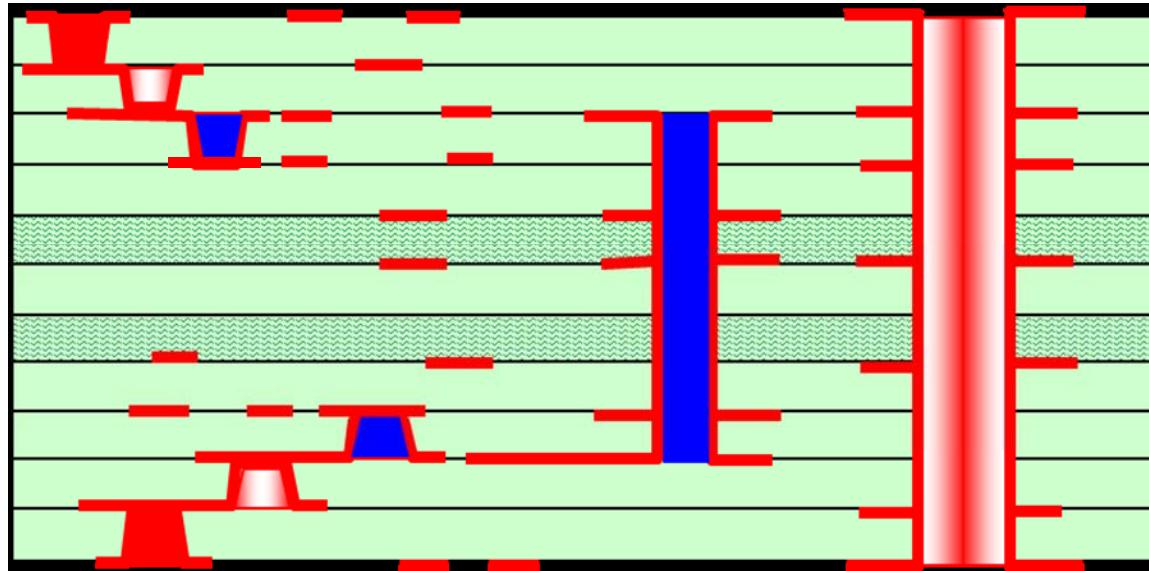


Evolution de la Technologie microvias Techci

2009



2.5 +X+2.5 (3 stratifications)

Bloc enterré rempli par résine spéciale, dépôt sous vide.

Face Top & Bottom : Vias Filled

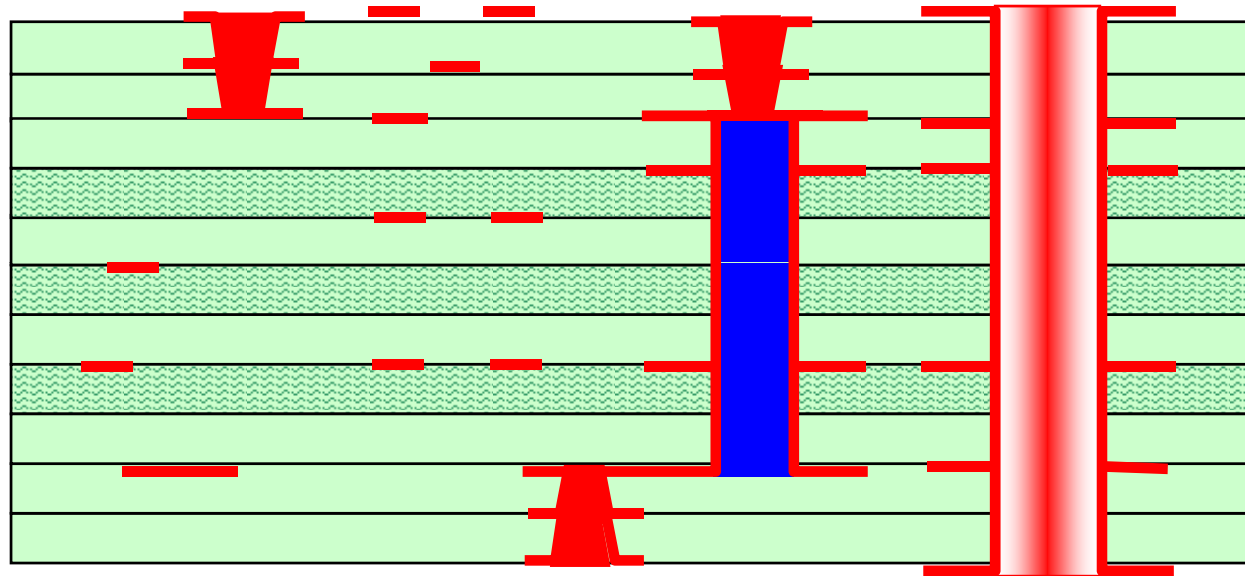
Pistes et isolements : 85 μ /100 μ

Pad interne : 300 μ

Ratio pour micro Vias : 0.8

VIAS IN PAD

2010



2+X+2 (3 Stratifications)

Stacked Vias : Vias Filled Top & Bottom & N-1

Bloc enterré rempli par résine spéciale, dépôt sous vide.

Pistes et isolements : 75 μ /85 μ

Pad interne : 300 μ

Ratio pour micro Vias : 0.8

VIAS IN PAD